

航空企服环批复〔2023〕15号

西安阎良国家航空高技术产业基地企业服务局关于 西安博尔新材料有限责任公司半导体碳化硅芯片 基础材料产业化项目环境影响报告书的批复

西安博尔新材料有限责任公司：

你公司报来的《西安博尔新材料有限责任公司半导体碳化硅芯片基础材料产业化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合该《报告书》专家意见，经审查，现批复如下：

一、项目位于西安阎良国家航空高技术产业基地航空四路152号，利用现有已建厂房，建设1条半导体碳化硅芯片基础材料生产线，建成后年产约500吨碳化硅粉体（包括普通粉体、高纯粉体、超细粉体和整形粉体）、500颗碳化硅单晶锭、10000片晶圆。项目总投资20000万元，其中环保投资20万元。

二、项目在严格落实《报告书》提出的各项环境保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。《报告书》所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。生活污水依托现有化粪池处理后同生产废水经市政污水管网排入西安阎良污水处理厂，污染物排放浓度应满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准相应限值要求。

（二）严格落实大气污染防治措施。烧结、筛分工序的粉尘通过集气罩进行收集，依托年产 500 吨高端精密磨具项目的废气处理设备袋式除尘器进行处理后经 15 米高排气筒（DA007）排放，废气经有效收集处理排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值；晶圆擦洗工序产生的有机废气由通风橱收集后采用两级活性炭吸附装置进行处理后经 15 米高排气筒（DA009）排放，废气经有效收集处理排放应满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表 1 电子产品制造标准限值；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表 3 的标准限值，厂区内监控点无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表 2 的标准限值。

（三）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、加装消声器等降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求。

(四) 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物实施分类收集、处理和处置。危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中有关规定，并定期送交有资质单位进行处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定。

四、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

(一) 根据《报告书》测算数据，核定该建设项目建成投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：COD \leq 0.047 吨/年、氨氮 \leq 0.007 吨/年、VOCs \leq 0.011 吨/年。

(二) 该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的应当重新报批该项目的环境影响报告文件。

(三) 项目建成后，依法按规定的标准和程序及时办理排污许可手续和开展竣工环保验收工作，按要求定期开展环境监测。

西安航空基地企业服务局

2023年6月9日